



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178308-5
△6	△3	178308-3
△6	△2	178308-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

C1	REVISED	ECR-07-013273	TS	DM	11/20/93
C	REVISED	(FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2/03
B	REVISED	(FJD0-0114-03)	TS	SM	25/APR/03
A	REVISED	(FJ00-2183-95)	K.I	SM	3/23/95
O	RELEASED	(FJ00-0017-93)	Y.T	S.M	2/8/93
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE

Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	
mm²(AWG)	mmφ	ダイナミック D3100 水平タイプ 20 極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL	FINISH	20 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	DE. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	100% : ±0.3 100% 300% : ±0.4 30% 100% : ±0.45 角 度 : ±3'	A3 J C-178308
CHK. 8-FEB-'93 S.MANABE	APP. 8-FEB-'93 S.MANABE	SCALE	REV SHEET
		2-1	C1 1 OF 1

NUMBER 178308
3rd ANGLE PROJECTION
METRIC
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178308-5](#)